

訂正版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007年4月19日 (19.04.2007)

PCT

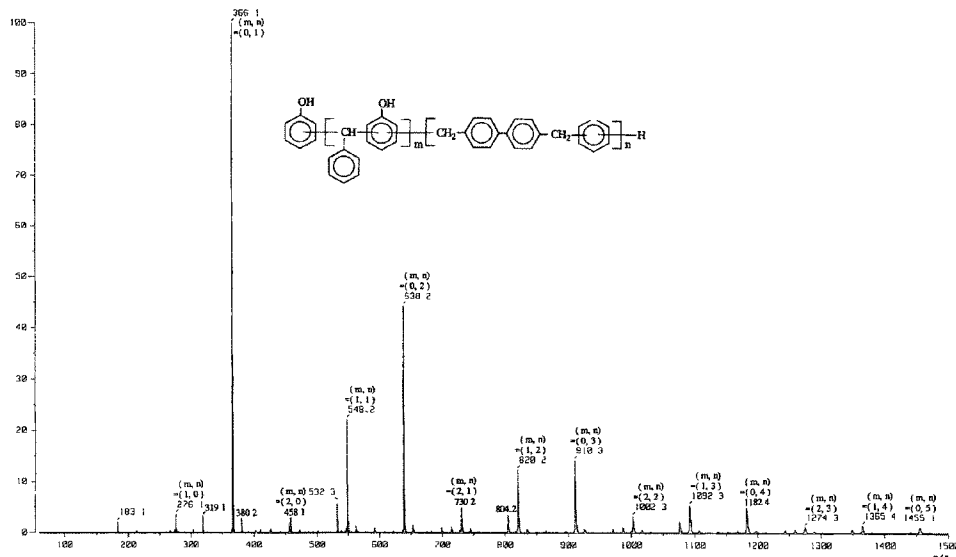
(10) 国際公開番号
WO 2007/043684 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 14/04 (2006.01) C08G 59/62 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/320581
- (22) 国際出願日: 2006年10月16日 (16.10.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2005-300126
2005年10月14日 (14.10.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): エアー・ウォーター株式会社 (AIR WATER INC.) [JP/JP]; 〒0600003 北海道札幌市中央区北三条西一丁目2番地 Hokkaido (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 村田 清貴 (MURATA, Kiyotaka) [JP/JP]; 〒3140014 茨城県鹿嶋市光3番地 エアー・ウォーター株式会社内 Ibaraki (JP).
曾根 嘉久 (SONE, Yoshihisa) [JP/JP]; 〒3140014 茨城県鹿嶋市光3番地 エアー・ウォーター株式会社内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 中嶋 重光 (NAKAJIMA, Shigemitsu); 〒1010053 東京都千代田区神田美土代町1-1-2 ニチヨビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

[続葉有]

(54) Title: PHENOL POLYMER, PRODUCTION METHOD THEREOF AND USE THEREOF

(54) 発明の名称: フェノール系重合体、その製法及びその用途



(57) Abstract: Disclosed is a phenol polymer having flame retardance, fast curability and low melt viscosity, which is useful as a curing agent for epoxy resin-based semiconductor sealing materials. Also disclosed are a method for producing such a phenol polymer and use of such a phenol polymer. Specifically disclosed is a phenol polymer obtained by reacting a phenol, a bismethylbiphenyl compound and an aromatic aldehyde at such a ratio that the molar ratio of the total of the bismethylbiphenyl compound and the aromatic aldehyde relative to the phenol is 0.10-0.60 and the aromatic aldehyde/the bismethylbiphenyl compound (molar ratio) is from 5/95 to 50/50. Also specifically disclosed is an epoxy resin composition composed of such a phenol polymer and an epoxy resin.

(57) 要約: 本願発明、エポキシ樹脂系半導体封止材における硬化剤として有用な、難燃性、速硬化性、低溶融粘度を兼ね備えたフェノール系重合体、その製法及びその用途を提供する。 本願発明は、フェノール類と、ビスメチルビフェニル化合物

[続葉有]



WO 2007/043684 A1



HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(48) この訂正版の公開日:

2007 年6 月7 日

(15) 訂正情報:

PCT ガゼットの No.23/2007 (2007 年6 月7 日)を参照

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

物と、芳香族アルデヒドを、フェノール類に対するビスメチルビフェニル化合物と芳香族アルデヒドの和のモル比が 0.10~0.60 であり、芳香族アルデヒド/ビスメチルビフェニル化合物 (モル比) が 5/95~50/50 となる割合で反応させて得られるフェノール系重合体、及び該フェノール系重合体とエポキシ樹脂からなるエポキシ樹脂組成物である。